

(外交防衛委員会)

マルチチップ集積回路に対する無税待遇の付与に関する協定の締結について承認を求めるの件

(閣条第三号) (衆議院送付) 要旨

この協定は、複数の集積回路をつなげて一体化したマルチチップ集積回路の無税待遇の早期実現に関する半導体業界団体からの提言を受け、二 四年 (平成十六年) 九月の第五回半導体に関する政府及び当局の間の会合 (我が国、韓国、米国、欧州共同体及び台湾により構成。以下「GAMS」という。) において議論が開始され、二〇〇五年 (平成十七年) 九月の第六回GAMSにおいて協定の内容につき実質合意し、同年十一月二十八日に作成されたものである。

この協定は、前文、(1) から (9) までの本文及び末文から成り、主な内容は次のとおりである。

一、締約者は、最恵国待遇の原則に基づき、マルチチップ集積回路に対して適用する関税その他の租税及び課徴金の率を無税とする。

二、締約者は、世界貿易機関 (以下「WTO」という。) の主催の下での関税の引下げに関する多数国間の合意が十分な水準のマルチチップ集積回路の国際的な貿易を対象としてしているとすべての締約者が認める時

(二〇〇六年十二月三十一日より前の場合には二〇〇七年一月一日)に、マルチチップ集積回路に対する関税その他の租税及び課徴金の率をWTO設立協定上無税とする譲許を行う。

三、この協定は、WTOの加盟国による受諾のために開放しておく。

四、この協定は、すべての締約者がマルチチップ集積回路に対する関税その他の租税及び課徴金の率をWTO

設立協定上無税とする譲許を行った時に終了する。